

(12) 特許協力条約に基づいて公開された国際出願

(19) 世界知的所有権機関
国際事務局



(43) 国際公開日
2011 年 6 月 30 日(30.06.2011)

PCT

(10) 国際公開番号
WO 2011/078106 A1

- (51) 国際特許分類:
G03F 7/075 (2006.01) G03F 7/022 (2006.01)
C08G 77/04 (2006.01) G03F 7/023 (2006.01)
C08G 77/14 (2006.01)
- (21) 国際出願番号: PCT/JP2010/072865
- (22) 国際出願日: 2010 年 12 月 20 日(20.12.2010)
- (25) 国際出願の言語: 日本語
- (26) 国際公開の言語: 日本語
- (30) 優先権データ:
特願 2009-290219 2009 年 12 月 22 日(22.12.2009) JP
- (71) 出願人 (米国を除く全ての指定国について): 東レ株式会社 (TORAY INDUSTRIES, INC.) [JP/JP]; 〒1038666 東京都中央区日本橋室町 2 丁目 1 番 1 号 Tokyo (JP).
- (72) 発明者; および
- (75) 発明者/出願人 (米国についてのみ): 藤原健典 (FUJIWARA, Takenori) [JP/JP]; 〒5208558 滋賀県大津市園山 1 丁目 1 番 1 号 東レ株式会社 滋賀事業場内 Shiga (JP). 内田圭一 (UCHIDA, Keiichi) [JP/JP]; 〒5208558 滋賀県大津市園山 1 丁目 1 番 1 号 東レ株式会社 滋賀事業場内 Shiga (JP). 谷垣勇剛 (TANIGAKI, Yugo) [JP/JP]; 〒5208558 滋賀県大津市園山 1 丁目 1 番 1 号 東

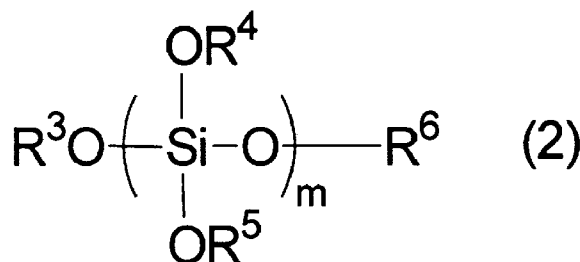
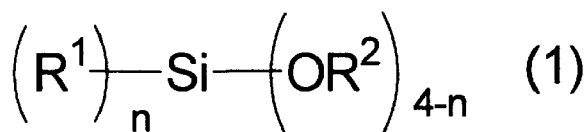
レ株式会社 滋賀事業場内 Shiga (JP). 諏訪充史 (SUWA, Mitsuhiro) [JP/JP]; 〒5208558 滋賀県大津市園山 1 丁目 1 番 1 号 東レ株式会社 滋賀事業場内 Shiga (JP).

- (81) 指定国 (表示のない限り、全ての種類の国内保護が可能): AE, AG, AL, AM, AO, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BH, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CL, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DK, DM, DO, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, GT, HN, HR, HU, ID, IL, IN, IS, JP, KE, KG, KM, KN, KP, KR, KZ, LA, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LY, MA, MD, ME, MG, MK, MN, MW, MX, MY, MZ, NA, NG, NI, NO, NZ, OM, PE, PG, PH, PL, PT, RO, RS, RU, SC, SD, SE, SG, SK, SL, SM, ST, SV, SY, TH, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, ZA, ZM, ZW.
- (84) 指定国 (表示のない限り、全ての種類の広域保護が可能): ARIPO (BW, GH, GM, KE, LR, LS, MW, MZ, NA, SD, SL, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), ユーラシア (AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, TM), ヨーロッパ (AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR), OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

[続葉有]

(54) Title: POSITIVE PHOTSENSITIVE RESIN COMPOSITION, CURED FILM FORMED FROM SAME, AND ELEMENT HAVING CURED FILM

(54) 発明の名称: ポジ型感光性樹脂組成物、それから形成された硬化膜、および硬化膜を有する素子



(57) Abstract: Disclosed is a positive photo-sensitive resin composition which contains a polysiloxane (a), a naphthoquinone diazide compound (b) and a solvent (c). The positive photo-sensitive resin composition is characterized in that the polysiloxane (a) has: an organosilane-derived structure represented by general formula (1) at a content ratio of 20-80% inclusive of Si relative to the overall number of moles of Si atoms in the polysiloxane; and an organosilane-derived structure represented by general formula (2). The positive photosensitive resin composition exhibits high heat resistance, high transparency, and enables high sensitivity, high resolution patterning. The positive photosensitive resin composition can be used to form cured films such as planarization films used in TFT substrates, interlayer insulating films, core materials and cladding materials, and can be used in elements having cured films such as display elements, semiconductor elements, solid-state imaging elements, and optical waveguide elements.

(57) 要約:

[続葉有]

WO 2011/078106 A1